

Ausstattung der AVT am HSG-IMIT

Halbautomatischer Die-Bonder und SMD-Bestücker

Diebonden ab Wafer
Diebonden ab Chip-Magazin
Bestücken mit sämtlichen SMT& Hybrid-Bauteilen
Dosieren von Klebstoffen und Lötpasten
Stempeln von Klebstoffen

Halbautomatischer Wedge-Wedge Drahtbonder

Aluminiumdraht
Golddraht

Halbautomatischer Ball-Wedge Drahtbonder

Golddraht

Halbautomatischer Pulltester

Halbautomatischer Fine-Placer

Flip Chip Technik
Feinpositionierung von Chips und SMD

Reflowlötöfen

Niederdruck-Plasmagerät

Oberflächenmodifikation von Bauteilen

Blitzlampengepulster Nd-YAG-Laser

Schweißen, Schneiden, Bohren von Metallen

Frequenzverdoppelter Nd-YAG-Laser

Mikrobearbeitung von Silizium

Diodenlaser

Lötapplikationen

Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. H. Ashauer
Tel. 07721 943 224
Fax. 07721 943 210
e-mail: heidi.ashauer@hsg-imit.de

Dr. M. Alavi
Tel.: 07721 9433 224
Fax.: 07721 943 210
e-mail: <mailto:mani.alavi@hsg-imit.de>